

PALTEK

(証券コード:7587)

2018年12月期 第3四半期 決算説明資料

2018.11.5 (月)

© 2018 PALTEK Corporation. All rights reserved.



| | 本資料取り扱い上の注意点

本資料に含まれる将来の見通しに関する記述は、現時点における情報に基づき 判断したもので、当社グループは、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、 発生の回避及び発生した場合の対応に努める所存であります。

なお、本資料においては、将来に関する事項が含まれておりますが、当該事項は 当連結会計年度末現在において判断したものであります。

また、実際の業績に影響を与えうるリスクや不確実な要素には、以下のようなも のが含まれます。

- ① 国内エレクトロニクス業界の急激な景気変動や需要動向の変化
- ② 仕入先の代理店政策の見直しや再編等により取引関係の継続が困難となった 場合
- ③ 不測の事態による当社グループの情報資産が流出した場合
- ④ 為替相場の急激な変動
- ⑤ 新規什入先商品の立ち上がりの遅れが生じた場合
- ⑥ 顧客の日本国内での製品開発案件が更に海外へシフトし、当社グループの販 売活動が及ばない地域へ移管された場合

- ① 2018年12月期 第3四半期 業績結果
- 2 2018年12月期 業績予想

3

⑤ 今後に向けた取り組み

© 2018 PALTEK Corporation. All rights reserved.





2018年12月期 第3四半期 業績結果



🧱 2018年12月期第3四半期業績結果

第3四半期(累計)業績結果 サマリ

- ■市場環境は自動車関連の産業機器は堅調だが、 通信インフラは低調に推移
- ■売上高は前年同期から減少するも、ほぼ想定どおりに推移
 - 通信市場の低迷、アナログ半導体メーカーとの契約解消が影響
- ■営業利益は前年同期から減少するも、ほぼ想定通りに推移
- ■経常利益・四半期純利益は、為替差損が大きく発生した ことによりに減少

5

© 2018 PALTEK Corporation. All rights reserved.

凞 連結業績結果

| | (百万円) | | 2017年第 | 第3四半期 | 2018年第 | 第3四半期 | 増減 | | |
|---|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--|
| | ענ ונגם) | | 金額 | 比率 | 金額 | 比率 | 増減額 | 増減率 | |
| 売 | 上市 | 高 | 24,821 | 100.0% | 22,841 | 100.0% | △1,979 | △8.0% | |
| 売 | 上総利 | 益 | 3,136 | 12.6% | 2,835 | 12.4% | △300 | △9.6% | |
| 販 | 管 | 費 | 2,444 | 9.8% | 2,363 | 10.3% | △81 | △3.3% | |
| 営 | 業利 | 益 | 691 | 2.8% | 472 | 2.1% | △219 | △31.7% | |
| 経 | 常利 | 益 | 759 | 3.1% | 217 | 1.0% | △541 | △71.3% | |
| | 社株主に帰る当期純利 | | 504 | 2.0% | 119 | 0.5% | △385 | △76.3% | |
| | 株 当 た 半期純利 | り 益 | 46.08円 | _ | 10.93円 | _ | △35.15円 | △76.3% | |

主な増減 要因

- 売上高の減少は、半導体事業の減少による
- 売上総利益の減少は、売上高が減少したことによる
- 経常利益の減少は、営業利益の減少のほか為替差損および支払手数料の 発生による



🚻 事業別売上高の状況

| (百万円) | 2017年第 | 第3四半期 | 2018年第 | 第3四半期 | 増減 | | |
|----------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--|
| (四/3/ 3/ | 金額 | 比率 | 金額 比率 | | 増減額 | 増減率 | |
| 半導体 | 23,579 | 95.0% | 21,461 | 94.0% | △2,117 | △9.0% | |
| デザインサービス | 1,103 | 4.4% | 1,246 | 5.4% | 142 | 12.9% | |
| ソリューション | 138 | 0.6% | 133 | 0.6% | △5 | △3.6% | |
| 売上高合計 | 24,821 | 100.0% | 22,841 | 100.0% | △1,979 | △8.0% | |

主な増減 要因

- 半導体事業は、通信機器向けの特定用途IC、アナログ半導体が減少
- デザインサービス事業は、医療機器、通信機器向けが増加

7

■ ソリューション事業は、乳幼児呼吸見守りシステム、IoTゲートウェ イが増加したものの、医療機関向け停電対策システムが減少

© 2018 PALTEK Corporation. All rights reserved.



職 売上総利益率の変動について

■ 売上総利益率の減少は、以下が要因

ドル円相場により変動する仕入先に対して保有する仕入値引ドル建 債権の評価額の増減等により売上総利益が、

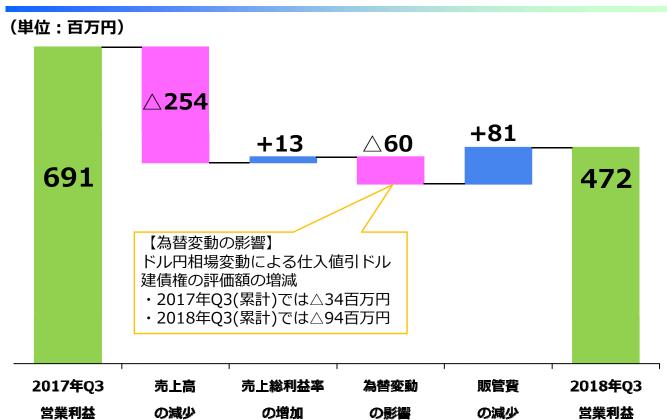
2017年第3四半期では△34百万円(△0.1%分)

2018年第3四半期では△94百万円(△0.4%分)の影響があった

| (百万円) | 2017年 | 第3四半期 | 2018年第3四半期 | | |
|-------------------------|-------|-------|------------|-------|--|
| | 金額 | 対売上比率 | 金額 | 対売上比率 | |
| 売 上 総 利 益 | 3,136 | 12.6% | 2,835 | 12.4% | |
| (うち為替の影響額) | △34 | △0.1% | △94 | △0.4% | |
| 売 上 総 利 益 (為替の影響を排除) | 3,170 | 12.8% | 2,930 | 12.8% | |



営業利益の増減分析



9

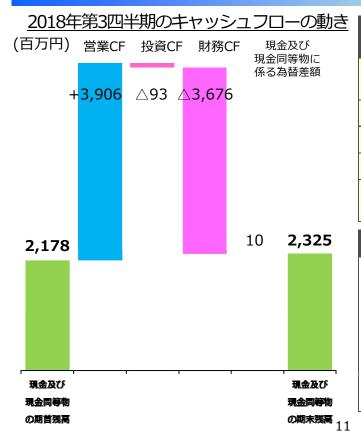
深 連結貸借対照表の状況

| | (百万円) | 2017.12 | 2018.09 | 増減額 | 主な増減理由 |
|--------|---------|---------|---------|--------|------------|
| | 現金及び預金 | 2,178 | 2,325 | 146 | |
| 資 | 売上債権 | 7,087 | 6,437 | △650 | |
| 産内 | 商品 | 3,559 | 3,251 | △308 | |
| 訳 | その他流動資産 | 3,904 | 1,410 | △2,493 | 未収入金が大幅に減少 |
| | 固定資産 | 450 | 496 | 46 | |
| 資 | | 17,180 | 13,921 | △3,259 | |
| 自 | 仕入債務 | 1,387 | 1,040 | △347 | |
| 債納 | 短期借入金 | 5,030 | 1,510 | △3,520 | 借入金返済を実施 |
| 負債純資産内 | その他流動負債 | 999 | 1,643 | 644 | |
| | 固定負債 | 261 | 247 | △13 | |
| 訳 | 純資産 | 9,501 | 9,478 | △22 | |
| 負值 | 責・純資産合計 | 17,180 | 13,921 | △3,259 | |

© 2018 PALTEK Corporation. All rights reserved.

PAL TEK

連結キャッシュ・フローの状況



| (百万円) | 2017年 第3四半期 | 2018年 第3四半期 |
|--------------------|----------------|----------------|
| 現金及び現金同 等物の期首残高 | 2,698 | 2,178 |
| 営業CF | △3,770 | 3,906 |
| 投資CF | △48 | △93 |
| 財務CF | 2,895 | △3,676 |
| 現金及び現金同 等物の期末残高 | 1,895 | 2,325 |

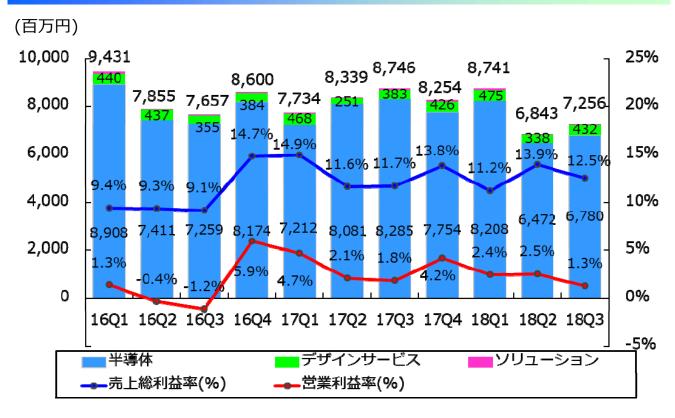
2018年第3四半期キャッシュフローの動き

- ■【営業CF】税金等調整前四半期純利 益の計上し、未収入金の減少等によ り収入
- ■【投資CF】投資有価証券、子会社株 式を取得したこと等により支出
- ■【財務CF】配当金支払いを実施した こと、借入れの返済等により支出

© 2018 PALTEK Corporation. All rights reserved.

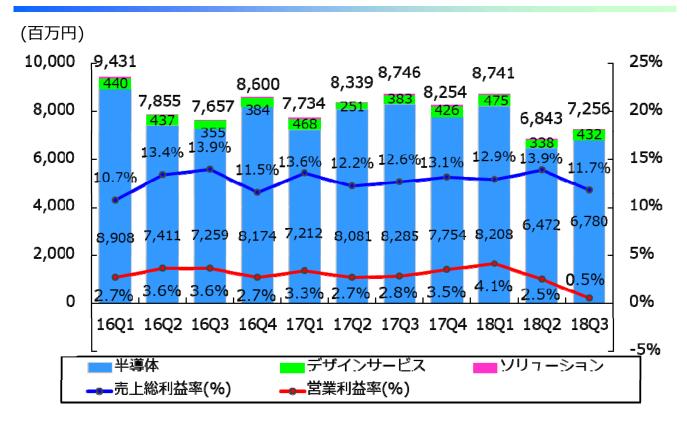
PAL TEK

連結業績の四半期推移





連結業績の四半期推移(為替の影響を除いた場合)



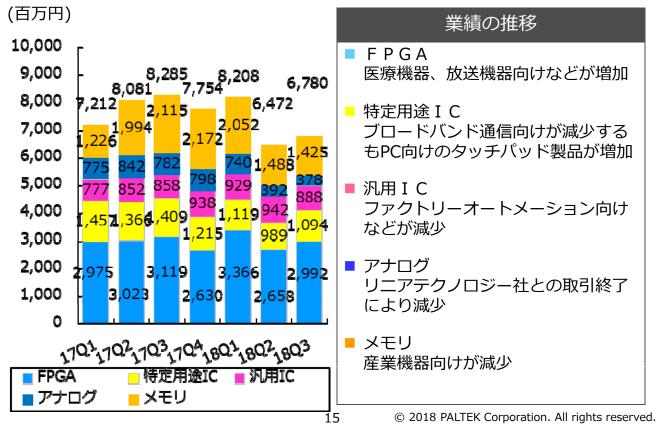
13

© 2018 PALTEK Corporation. All rights reserved.

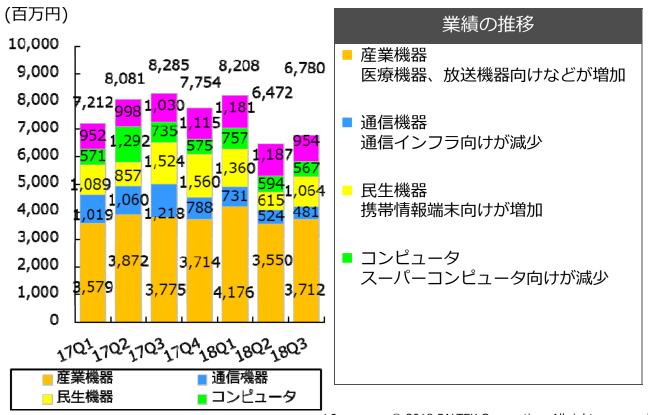


事業別の実績

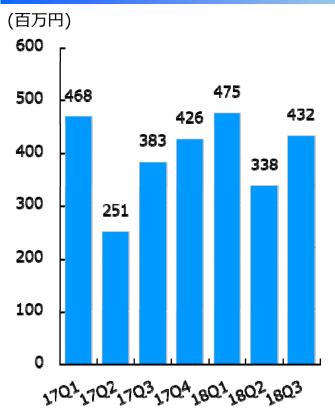
半導体事業の状況(製品別)



半導体事業の状況(用途別)



凞 デザインサービス事業の状況



業績の推移 通信機器、産業機器向けの案件が 増加

17

© 2018 PALTEK Corporation. All rights reserved.



2

2018年12月期 業績予想



2018年12月期 業績予想

売上高、営業利益はほぼ想定通り推移しているものの、 経常利益・親会社株主に帰属する当期純利益は想定を下回って推移

■ 今後の見通し

- 直近の市場環境悪化により、景気減退の可能性あり 為替に関しても変動要素あり
- 第3四半期(累計)までの売上高、営業利益は想定通り推移
- 経営利益および親会社株主に帰属する当期純利益は、 第3四半期までに為替差損183百万円が発生したことにより、 想定を下回って推移
- 不透明要素が多いため見通しは変更せず

© 2018 PALTEK Corporation. All rights reserved. 19

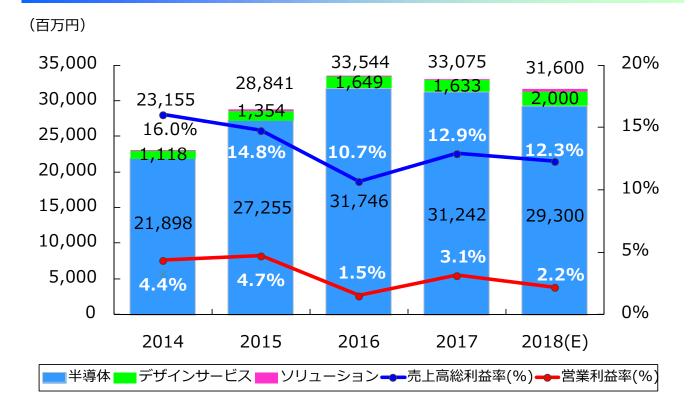


凞 2018年12月期 業績予想

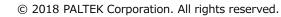
| | 2017年12月期 実績 | | | | 12月期 第 月1日修Ⅱ | 通期増減 | | |
|---------|--------------|--------|--------|--------|-----------------|--------|--------|--------|
| (百万円) | 上期 | 下期 | 通期 | 上期 | 下期 | 通期 | 増減額 | 増減率 |
| 売 上 高 | 16,074 | 17,001 | 33,076 | 15,585 | 16,014 | 31,600 | △1,475 | △4.5% |
| 売上総利益 | 2,116 | 2,158 | 4,275 | 1,931 | 1,968 | 3,900 | △375 | △8.8% |
| 売上総利益率 | 13.2% | 12.7% | 12.9% | 12.4% | 12.3% | 12.3% | _ | _ |
| 販 管 費 | 1,583 | 1,654 | 3,237 | 1,549 | 1,670 | 3,220 | △17 | △0.5% |
| 営業利益 | 533 | 504 | 1,037 | 381 | 298 | 680 | △357 | △34.5% |
| 営業利益率 | 3.3% | 3.0% | 3.1% | 2.4% | 1.9% | 2.2% | _ | _ |
| 経 常 利 益 | 563 | 521 | 1,084 | 227 | 242 | 470 | △614 | △56.7% |
| 当期純利益 | 370 | 332 | 703 | 133 | 166 | 300 | △403 | △57.3% |



業績見通しの推移



21







今後に向けた取り組み

飛 PALTEKの方向性

■ 経営方針

- ソリューションサプライヤーとして社会的意義ある価値を創出し、ニーズとシーズを照らし合わせた、付加価値の高い製品提案、ソリューションの開発を推進
- 収益性の高い経営を目指す

■ 各事業の方向性

ソリューション事業

培ってきた技術力をベースに、最終製品レベルの ソリューションを開拓、開発、販売

デザインサービス事業

画像処理・FPGA設計などコア技術の強みを 活かし、ODMビジネスを拡大、収益性を向上

半導体事業

成長市場にフォーカスし、安定的に収益を 上げていく事業ポートフォリオを構築

© 2018 PALTEK Corporation. All rights reserved.

PAL TEK

半導体事業について

【事業環境】

- AI、ビッグデータ、IoTの活用により半導体市場が拡大
 - さまざまなモノがインターネットに接続され、IoT関連やデータセンター向けの半導体市場が成長
- 車載分野およびその周辺市場は堅調
 - 自動運転、電気自動車(EV)が更に発展

取り組み

- AIソリューションの構築
- IoT、データセンター、車載周辺市場などの成長分野に 提案力を強化

(Xilinx, Micron, NXP, Microchip, MPS)

₩ FPGA市場への取り組み

■ AI ソリューション構築のため協業開始

- 医療分野、産業分野、通信分野を中心に展開中
- AI搭載モジュール販売開始(新規顧客開拓)

■ アクセラレーション開発キット販売

- "より高性能"、"より低レイテンシ"を実現
- 動画配信、ビックデータ、AI関連へ展開

新製品提案/新規案件獲得

- アナログ搭載 "RFSoC" の提案力強化
- 無線、テスト/計測、レーダー等の分野に最適

■ FPGA+マルチ商材提案

XILINX + (Micron/Memory, MPS/Power)



アクセラレーション開発キット



XILINX: RFSoC





© 2018 PALTEK Corporation. All rights reserved.

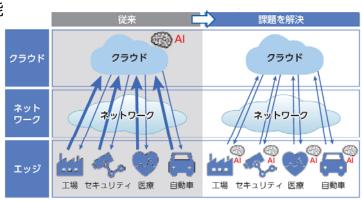
脳 AIソリューションの構築

■ エッジ向けAIソリューションを開拓

IoTにおいて、エッジコンピューティングへのニーズが高まる 【3つの課題】

25

- クラウドとの通信処理で遅延が発生
- セキュリティ面でのリスク
- インターネット環境が不安定だと処理停止
- エッジコンピューティングでのAI活用においては、FPGAが最適
 - システム環境の変化に柔軟に対応が可能
 - リアルタイム処理が可能
 - 低消費電力
 - 長期供給が可能





💹 エッジAIソリューションの強化

- エッジ側での 画像処理 AI (in FPGA)
 - ディープラーニング・ソリューション
- 【用途】分類/検出/セグメンテーション 一般的ディープラーニング技術を小型 / 高速 / 低電力
- スパースモデリング・ソリューション



【用途】特徵抽出 / 移動体検出 小型なアルゴリズムでディープラーニングと比べ、 学習量が少なくて済む

© 2018 PALTEK Corporation. All rights reserved.

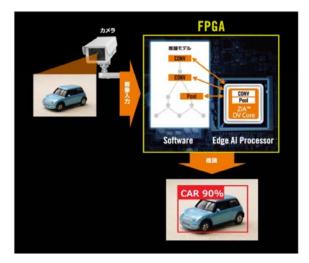
27

凞 エッジ向け FPGA AIモジュール販売

<AI推論処理に特化したAIプロセッサ>

ハードウァアを意識する必要なく、 学習モデルをAIモジュールで動作可能。 FPGAで実現のために、AI機能進化に 応じてハードウェアアップデート可能へ





ディープラーニングの推論処理をプロセッサに組み込む FPGAにより小型化、高性能化、低消費電力化を実現

PAL TEK

メモリ、プロセッサ、汎用ICなど主要3製品での取り組み

- 成長市場へ新規案件活動に注力
 - データセンター
 - AI / IoT
 - 産業機器
 - 医療機器
- マルチ商材提案力 (新規案件獲得強化)
- 営業効率化の強化

(例: Memory + Power + Interface)



主要3製品の売上推移

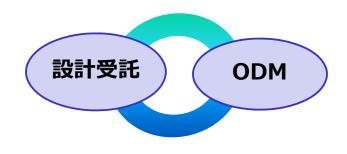
(海外向け情報端末用メモリの売上高は除く) © 2018 PALTEK Corporation. All rights reserved.

PAL,

デザインサービス事業について

29

- 製品実現に向けた提案から設計・試作・ 評価・量産までを設計・製造受託
- 事業構成
 - 設計受託
 - ODM
 - 開発サポート製品販売



<u>提供するサービス</u>

ハード/ソフト設計 コンサルティング 仕様検討 機構設計 試作製造 評価・検証 量産・製造 調達代行

強み

※ ODM (Original Design Manufacturing): 発注元企業のブランドで販売される製品を設計するだけでなく 製造も行うこと

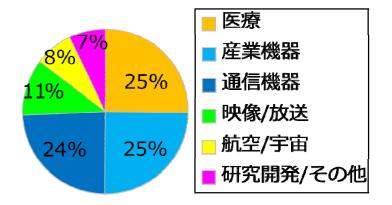


設計受託およびODMの状況

- 医療機器、通信機器での設計受託・ODMが堅調
 - 医療
 - 診断装置

用途別売上構成(2018年Q3)

- 産業機器
 - 半導体製造装置
 - 産業用ロボット
- 通信機器
 - 無線通信インフラ
- 映像/放送機器
 - 4K/8K関連機器



© 2018 PALTEK Corporation. All rights reserved.

31

■ ソリューション事業の狙い

- 市場拡大が見込まれる分野に注力したソリューションを発掘・開発
- 将来的にIoTやサービス等の付加価値の可能性のあるソリューション を展開





🔐 SRT搭載 4K対応コーデックシステム開発

■ 不安定な伝送路でも映像データを伝送できる秘匿性の 高い4K対応 H.265/HEVCコーデックシステムを開発

【特長】高画質、低遅延、セキュアな画像伝送を実現



【SRTプロトコルについて】

SRTプロトコルはHaivision社が開発し、 2017年4月にオープンソース化された、 不安定なネットワーク環境に強く、 高品質のまま映像を伝送できる次世代の 伝送規格。

SRT普及を推進するSRTアライアンス には、Microsoft社なども加盟。



© 2018 PALTEK Corporation. All rights reserved.

33

欧州最大の放送機器展「IBC 2018」に出展

■ 欧州最大の放送機器展「IBC 2018」に出展

開催日時 : 2018年9月14日(金)~18日(火)

: オランダ アムステルダム

■ SRT搭載 4K対応H.265/HEVCコーデック システムなどを展示



■ SRT搭載コーデックシステムを展示していたため、 多くの方に来場いただき、海外展開の足掛かりを増やす







PAL TEK

紙梱包資材システムのビジネス進捗

■ ビジネスの位置づけ

- 成長すると見込まれる物流分野への事業展開
- 生態系への影響懸念により脱プラスチックが進む中、 プラスチック系緩衝材に代わる紙緩衝材活用による物流コスト低減提案

■ 国際物流総合展に出展

- 開催日時:2018年9月11日(火)~14日(金)
- 自動紙緩衝材梱包システムのアジア初の動態展示
- 1300人以上に来場いただき、多くの引き合いをいただく







■ ビジネスの進捗状況

• トライアル (累計):19社(29台)

• 採用 (累計): 9社(60台)大手物流会社、通販会社など

© 2018 PALTEK Corporation. All rights reserved.

PAL TEK

乳幼児呼吸見守りシステムのビジネス進捗

■ ビジネスの位置づけ



- 女性の社会進出を支える「子ども子育て支援新制度」の一環で、 乳幼児保育を支援するため、新規分野へ展開
- 当社で開発・製造面も請け負う

■ 乳幼児呼吸見守りシステム「IBUKI ONE」に加え、 保育施設向け午睡チェックアプリ「IBUKI NAP」を提供開始

- うつぶせ寝による事故防止策の一環で、乳幼児の睡眠中、5分または10分毎に呼吸や体の向きを目視確認して、午睡チェック表に記録
- 保育士の精神的負担を軽減、作業負担を大幅に削減

■ 販売プロモーション

保育施設向けに全国展開 している会社なども活用し、 販売実施





28 ウェアラブルロボットのビジネス進捗

■ビジネスの位置づけ

介護、建設、農業分野などでの腰痛を予防することで 労働環境の改善を支援

■ ウェアラブルロボット「マッスルスーツ®」販売開始

- 電気、センサー、モーターを使わず空気圧式の人工筋肉 で、重労働時の身体にかかる負担を軽減
- 充電などの必要がないため、継続的に使用可能



■ ターゲット市場

介護



建設



農業



37

© 2018 PALTEK Corporation. All rights reserved.





為替変動に関する影響

39

© 2018 PALTEK Corporation. All rights reserved.

PAL TEK

為替変動による影響について

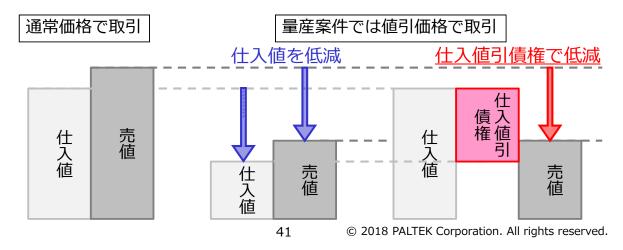
- 為替変動により当社グループの利益は以下の4点で影響 を受けます
 - ① 仕入値引ドル建債権の為替変動による影響
 - ② 調達在庫の為替変動による影響
 - ③ 決済時のドル調達レート変動による影響
 - ④ ドル建売掛金入金時のレート変動による影響



為替変動による影響の発生要因①

【仕入値引ドル建債権の為替変動による影響】

- 当社が仕入先に対して保有する<u>『仕入値引ドル建債権』が、為替レートの変動により評価額が増減することで、業績に大きな影響を与える</u>
- 仕入値引ドル建債権について:
 - 量産案件によっては、通常価格よりも低い価格での販売を要請されることがある
 - その場合、仕入先との間で仕入価格の低減交渉を行う
 - その実現方法は、「仕入値自体の低減」と「仕入値引債権の付与による低減」

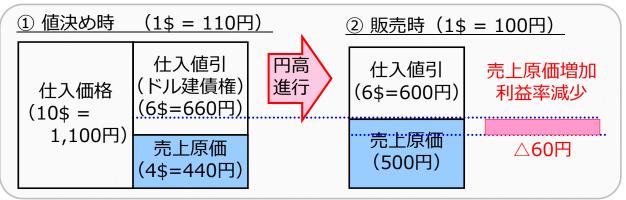


PAL TEK

急速な円高進行による仕入値引債権の評価額減少

- 仕入値引債権の評価額の増減は、値決め時と販売時の為替レートの差により生じる
- そのため、急速に円高が進行すると、為替レートの差が大きく 生じるため、仕入値引債権の評価額が大幅に減少
- これにより、売上原価が増加し、売上総利益が減少

例: 仕入れ価格10ドルの製品を販売する際の売上原価の変化



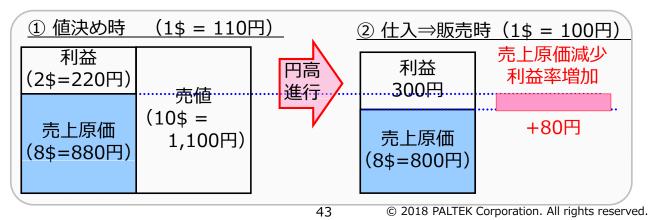


為替変動による影響の発生要因②

【調達在庫の為替変動による影響】

■ 海外から仕入れたドル建の製品において、為替レートが円高に 進行することにより、売上原価が減少し、売上総利益は増加

例:仕入れ価格10ドルの製品を販売する際の売上原価の変化

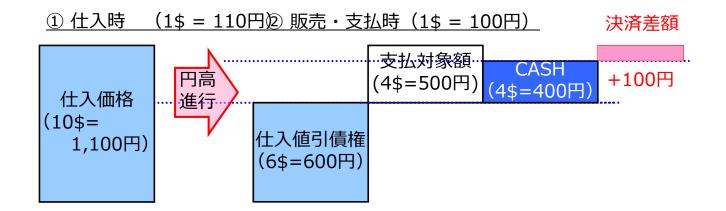


PAL TEK

為替変動による影響の発生要因③

【決済時のドル調達レート変動による影響】

- 支払を行う際に円高に進行していた場合、ドルを調達する金額が 少なくなるため、決済差額が生まれ、為替差益を計上することと なる
- 一方、円安に進行した場合は、為替差損を計上することとなる





為替変動による影響の発生要因4

【ドル建売掛金入金時のレート変動による影響】

- ドル建売掛金の入金がある場合には、円高に進行するとマイナス、 円安に進行するとプラスの影響が発生する(営業外の為替差損益)
- 当社はこのリスクを限定的にするために、為替予約を行っている
 - ① 販売時 (1\$ = 110円)
- ② 入金時(1\$ = 100円) 決済差額

売掛金 (10\$= 1,100円)



入金額 (10\$= 1,000円) △100円

45

© 2018 PALTEK Corporation. All rights reserved.



為替変動の影響額(2018年第3四半期)

- 売上総利益への影響額
 - 為替レートが円安に進行したことにより、為替変動の影響額はプラス方向に

| (単位:百万円) | 17Q1 | 17Q2 | 17Q3 | 17Q4 | 18Q1 | 18Q2 | 18Q3 |
|-----------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------------|-------------|
| 為替レートの変動 (円) | 117→ (110)→ 111 | 111→ (108- 114)→ 112 | 112→ (114- 107)→ 112 | 112→ (114- 110)→ 112 | 113→ 106 | 106→ (111)→ 109 | 111→ 113 |
| 為替変動の影響(売上総利益) | 102 | -52 | -83 | 56 | -148 | 3 | 52 |
| 仕入値引債権の評価額変動の影響 | 128 | -156 | -62 | 109 | -338 | -8 | 307 |
| 調達在庫の為替レート変動の影響 | -26 | 104 | -21 | -53 | 189 | 11 | -256 |

- 営業外損益への影響額 (期末評価替の影響は含まず)
 - 買掛金支払時のレート変動の影響は、為替レートが円安に進行したことによりマイナス方向に(売上総利益への影響と、おおよそ相殺関係となる)

| (単位:百万円) | 17Q1 | 17Q2 | 17Q3 | 17Q4 | 18Q1 | 18Q2 | 18Q3 |
|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 買掛金支払時のレート変動の影響 (営業外) | 36 | 46 | 54 | -24 | 88 | -19 | -89 |

売掛金受取時のレート変動の影響額は、為替レートが円安に侵攻したことによりプラス方向に(為替予約実施のため変動影響は縮小されている)

| (単位:百万円) | 17Q1 | 17Q2 | 17Q3 | 17Q4 | 18Q1 | 18Q2 | 18Q3 |
|--------------------------|------|------|------|----------|------|---------|----------------|
| 売掛金受取時のレート変動の影響 (営業外) | 25 | -29 | -34 | 12 | -74 | -25 | 41 |
| - | | 1.0 | G 20 | 10 DALTE | 1/ C | L' A II | to be a second |

46

© 2018 PALTEK Corporation. All rights reserved.



/ 2018年12月期 製品別業績予想

| 2017年12月 | | | 年12月期 | 実績 | 2018年 | 12月期 第 | 美績予想 | 通期増減 | |
|----------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|--------|--------|
| | (百万円) | 上期 | 下期 | 通期 | 上期 | 下期 | 通期 | 増減額 | 増減率 |
| * | 導体 | 15,239 | 16,040 | 31,334 | 14,681 | 14,618 | 29,300 | △2,034 | △6.5% |
| | FPGA | 5,999 | 5,750 | 11,749 | 6,025 | 5,874 | 11,900 | 150 | 1.3% |
| | 特定用途IC | 2,824 | 2,624 | 5,448 | 2,109 | 1,840 | 3,950 | △1,498 | △27.5% |
| | 汎用IC | 1,630 | 1,797 | 3,428 | 1,871 | 1,878 | 3,750 | 321 | 9.4% |
| | アナログ | 1,618 | 1,580 | 3,199 | 1,133 | 866 | 2,000 | △1,199 | △37.5% |
| | メモリ | 3,221 | 4,287 | 7,508 | 3,541 | 4,158 | 7,700 | 191 | 2.5% |
| デ | ザインサービス | 719 | 810 | 1,530 | 814 | 1,185 | 2,000 | 469 | 30.7% |
| ソ | 'リューション | 60 | 150 | 211 | 89 | 210 | 300 | 88 | 42.0% |
| 売 | 上高合計 | 16,074 | 17,001 | 33,075 | 15,585 | 16,014 | 31,600 | △1,476 | △4.5% |
| 営 | 業利益 | 533 | 504 | 1,037 | 381 | 298 | 680 | △357 | △34.5% |

47

© 2018 PALTEK Corporation. All rights reserved.



₩ 開示区分について

| | 開示区分 | 内容説明 |
|----|-------------|---|
| 半導 | 拿体事業 | 半導体及び関連製品の販売、技術支援 |
| | FPGA | ザイリンクス社のFPGAやSoCなどを中心とするソリューション |
| | 特定用途IC | 特定用途に特化した半導体を中心とするソリューション (例:通信向け、インタフェース向け、携帯端末向け等) |
| | 汎用IC | NXPセミコンダクターズ社、マイクロチップテクノロジー社等の汎用ICを中心とするソリューション |
| | アナログ | アナログ半導体を中心とするソリューション |
| | メモリ | マイクロンテクノロジー社等のメモリを中心とするソリューション |
| デサ | ゲインサービス事業 | 受託開発、ODM/EMS/OEM |
| ソレ | リューション事業 | 最終製品レベルでのソリューション提案を実施 自社製品(ハードウェア、ソフトウェア、システム)の 開発・販売 |
| | | 48 © 2018 PALIEK Corporation. All rights reserved |



以下の担当までお問い合わせ下さい。

株式会社PALTEK

柴崎 由記 (IR担当)

〒222-0033

横浜市港北区新横浜2-3-12 新横浜スクエアビル

TEL : 045-477-2072 FAX : 045-477-2012 E-mail : ir@paltek.co.jp